

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分
 【発行日】平成 19 年 2 月 15 日 (2007.2.15)

【公開番号】特開 2005-302605 (P2005-302605A)
 【公開日】平成 17 年 10 月 27 日 (2005.10.27)
 【年通号数】公開・登録公報 2005-042
 【出願番号】特願 2004-119250 (P2004-119250)
 【国際特許分類】

H 0 5 B 33/04 (2006.01)

H 0 1 L 33/00 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

【F I】

H 0 5 B 33/04

H 0 1 L 33/00 N

H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】
 【提出日】平成 18 年 12 月 21 日 (2006.12.21)
 【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体である導電材料を有する素子と、前記素子を載置している基材と、前記基材上で前記基材と共に前記素子をカバーするカバーとを有する半導体装置において、

前記カバーの端部は前記基材と直接接しており、

前記端部の側壁および前記基材に紫外線硬化型樹脂が配置されていることで前記素子が前記基材と前記カバーによって封止されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

前記紫外線硬化型樹脂は、前記基材と前記カバーの端部の側壁のみに配置されていることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 3】

前記カバーは凹部を有し前記凹部と前記基材との間に前記素子が配置されていることを特徴とする請求項 2 に記載の半導体装置。

【請求項 4】

前記カバーは凹部を有さないフィルムであり、自重によりたわむことで前記端部が前記基材に接していることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 5】

前記素子は、一对の電極と前記一对の電極の間に配置される少なくとも 1 層の前記導電材料である有機層とを有する有機発光素子であることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか一項に記載の半導体装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 0】

よって本発明は、

半導体である導電材料を有する素子と、前記素子を載置している基材と、前記基材上で前記基材と共に前記素子をカバーするカバーとを有する半導体装置において、

前記カバーの端部は前記基材と直接接しており、

前記端部の側壁および前記基材に紫外線硬化型樹脂が配置されていることで前記素子が前記基材と前記カバーによって封止されていることを特徴とする半導体装置を提供する。